



广东某封装基板项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

项目名称：广东某封装基板项目可行性研究报告

项目性质：新建项目

项目地点：广东

项目背景：

IC 封装基板行业一直是我国鼓励发展的行业。2009 年 9 月，发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局颁布了《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》，并指出半导体集成电路、电子基础产品等 7 个领域是电子信息产业技术进步和技术改造投资的主要方向，其中重点支持高密度互联多层印制电路板、多层挠性板，刚挠印制电路板、IC 封装基板、特种印制电路板等电子材料的发展。

建设规模：

项目将建设电镀车间、LDI 车间、磨板车间等建筑内容。



广东某封装基板项目

项目市场分析：

随着集成电路产业链的产业分工日益专业化、精细化，圆晶制造、封装测试和封装基板制造逐步向亚洲转移。目前封装基板制造主要集中在日本、韩国和中

国台湾,中国大陆封装基板行业逐渐发展,有少部分本土企业进入封装基板行业,同时由于人力及土地成本等原因,日韩台部分封装基板厂商也纷纷到中国大陆建分厂。2012 年日本、韩国和中国(包括中国台湾地区)共实现封装基板销售收入 79.19 亿美元, 占全球封装基板份额的 95.27%。

项目总投资:

本项目总投资 62000 万元。

研究结论:

该项目建成达产后,所得税后财务内部收益率为 28.21%,财务净现值 31599 万元,投资回收期 6.9 年(含建设期),具有较好的经济效益。

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 0531-82861936 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层

联系电话：022-87079220 022-58512376 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869